

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于申请银行授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司 2019 年在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的授信额度 1,000 万元所对应的银行贷款到期日为 2020 年 5 月 5 日、授信额度 1,500 万元所对应的银行贷款到期日为 2020 年 9 月 28 日。现公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

上述交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议了《关于公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议并通过。

现因公司生产经营需要，公司拟增加向上海农村商业银行张江科技支行申请的综合授信额度，故将该议案进行更新后重新提交公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议审议，本次董事会会议中，出席会议的杨裕镜先生、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、何正宇（HO CHENG-YU）先生作为关联董事，表决时进行了回避。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，因非关联董事不足半数，相关议案尚需提交公

司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州惠利电子材料有限公司

住所：广州市经济技术开发区东区骏功路 39 号

注册地址：广州市经济技术开发区东区骏功路 39 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：杨裕镜

实际控制人：杨裕镜、游仲华

注册资本：人民币 4135.2487 万元

主营业务：油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；树脂及树脂制品批发；进出口商品检验鉴定；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；新材料技术开发服务；

关联关系：广州惠利电子材料有限公司为公司的全资子公司

2. 自然人

姓名：杨裕镜

住所：上海市嘉定区

关联关系：杨裕镜先生为公司的实际控制人之一，担任公司董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方杨裕镜先生、公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司为公司向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度提供无偿信用担保，不存在向公司收取费用、损害公司及其他股东利益的情形，其行为未违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

由于公司 2019 年在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的授信额度 1,000 万元所对应的银行贷款到期日为 2020 年 5 月 5 日、授信额度 1,500 万元所对应的银行贷款到期日为 2020 年 9 月 28 日。现公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联方为公司提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，是公司业务发展的需要，是合理的、必要的。

本次关联方为公司银行授信提供信用担保的关联交易，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日